

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

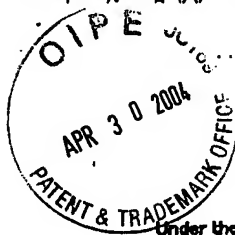
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to collection of information unless it displays a valid OMB control number.

PTO/SB/108 (8-86)

Approved for use through 9/30/98 OMB 0651-NK39

Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Seiko Epson Ref. No.: F008426US00

Attorney's Ref. No.: 81754.0108

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、私書箱、国籍は、下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者（下記の氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者であると（下記の名称が複数の場合）信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

半導体装置及びその製造方法、半導体装置用カバー、回路基板並びに電子機器SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD OF MANUFACTURING THE SAME, COVER FOR SEMICONDUCTOR DEVICE, AND ELECTRONIC EQUIPMENT

上記発明の明細書（下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付）は、

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☒ 2003年11月25日に提出され、米国出願番号または特許協定条約 国際出願番号を 10/722,365 とし、（該当する場合） _____ に訂正されました。

☒ was filed on November 25, 2003, as United States Application Number or PCT International Application Number 10/722,365 and was amended on _____ (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編第1条5.6項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

PTO/SB/108 (8-88)

Approved for use through 8/31/98 OMB 0651-0032

Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条(a)-(d)項又は365条(b)項に基づき下記の、米国以外の国の少なくとも1ヶ国を指定している特許協力条約365条(a)項に基づく国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s)
外国での先行出願

Priority Not Claimed
優先権主張なし

<u>2002-343816</u> (Number) (番号)	<u>Japan</u> (Country) (国名)	<u>27/November/2002</u> (Day/Month/Year Filed) (出願年月日)
<u> </u> (Number) (番号)	<u> </u> (Country) (国名)	<u> </u> (Day/Month/Year Filed) (出願年月日)

☐☐

私は、第35編米国法典119条(a)項に基づいて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119 (a) of any United States provisional application(s) listed below.

<u> </u> (Application No.) (出願番号)	<u> </u> (Filing Date) (出願日)	<u> </u> (Application No.) (出願番号)	<u> </u> (Filing Date) (出願日)
--	---	--	---

私は下記の米国法典第35編120条に基づいて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約365条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条第1項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願書提出日以降で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条56項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365 (c) of any PCT International application designating the United States, listed below and insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application:

<u> </u> (Application No.) (出願番号)	<u> </u> (Filing Date) (出願日)	<u> </u> (Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係属中、放棄済)
<u> </u> (Application No.) (出願番号)	<u> </u> (Filing Date) (出願日)	<u> </u> (Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

私は、私自身の知識に基づいて本宣言書中で私が行なう説明が真実であり、かつ私が入手した情報と私の信じることに基づく説明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の説明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の説明を行えば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

PTO/GB/108 (8-06)

Approved for use through 8/30/98 OMB 0551-U032

Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状: 私は、下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米特許商標局に対して遂行する弁理士または代理人として、下記の者を指名いたします。(弁理士、または代理人の氏名及び登録番号を明記のこと)

Stuart Lubitz (Reg. 20,680)
 Louis A. Mck (Reg. 22,585)
 John P. Scherlachner (Reg. 23,009)
 William H. Wright (Reg. 36,312)
 David Lubitz (Reg. 38,229)
 Wei-Ning Yang (Reg. 38,890)
 Alfred A. D'Andrea, Jr. (Reg. 27,752)
 William J. Kubida (Reg. 28,864)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. (list name and registration number)

Stuart T. Langley, (Reg. 33,840)
 Michael Byorick, (Reg. 34,131)
 Carol W. Burton, (Reg. 35,485)
 Steven C. Peterson, (Reg. 36,238)
 Steven K. Barton, (Reg. 36,445)
 Sarah S. O'Rourke, (Reg. 41,226)
 E. Matthew G. Dyor, (Reg. 42,278)

書類送付先:

HOGAN & HARTSON LLP.
 Biltmore Tower
 500 S. Grand Ave. Ste. 1900
 Los Angeles, CA 90071

Send Correspondence to:

HOGAN & HARTSON LLP.
 Biltmore Tower
 500 S. Grand Ave. Ste. 1900
 Los Angeles, CA 90071

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

HOGAN & HARTSON LLP.
 213-337 6700

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

HOGAN & HARTSON LLP.
 213-337-6700

唯一または第一発明者名

大森 治

Full name of sole or first inventor

Osamu OMORI

発明者の署名

日付

大森 治

2004年3月31日

Inventor's signature

Osamu Omori

Date

March 31, 2004

住所

日本国 長野県

富士見町

Residence

Fujimi-machi, Nagano-ken, Japan

国籍

日本

Citizenship

Japan

私書箱

392 8502 日本国長野県諏訪市大和3丁目3番5号
 セイコーエプソン株式会社内

Post Office Address

c/o Seiko Epson Corporation

3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

第二共同発明者

Full name of second joint inventor, if any

第二共同発明者の署名

日付

Second inventor's signature

Date

住所

日本国

Residence

Japan

国籍

Citizenship

私書箱

Post Office Address

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をすること)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)